

SV-SMT 7.62IT/04/90MSF2 2.6SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

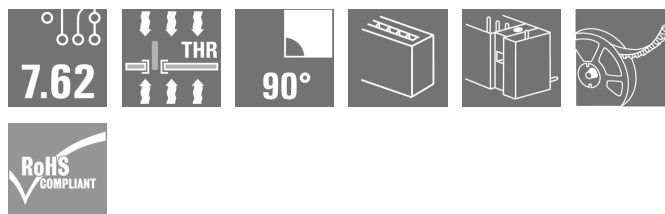
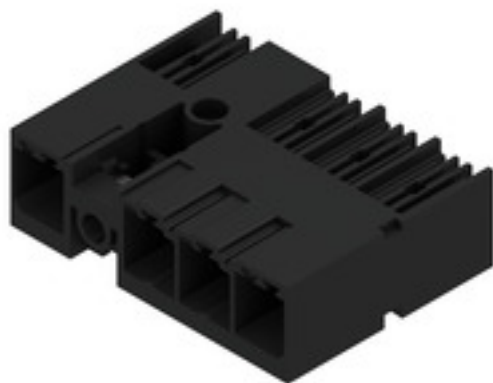
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



IT ネットワーク対応 OMNIMATEPower50 kVA

まで拡張可能特別な要件に合わせて個別調整されたソリューション

さらなる規格準拠性は、より少ない妥協が可能になります。IT ネットワークに対応する OMNIMATEPower には、さまざまな分野での標準機能が組み込まれています。これにより、形状および認可のプロセスが簡素化され、安全で信頼性の高い運用が可能になります。

アプリケーションの成果とユーザの利点：IEC 61800-5-1 (+ 5.5mm) に準拠して、400 V の IT システムでの使用と接触安全性を実現。自己保持式の片手で取り扱い可能な安全フランジは、直感的で安全な使用を可能にします。また、プラグイン時のセルフインターロック機能により、動作の信頼性を保証しています。

結果として、追加のデバイスカバーは必要ありません。アプリケーション指向の設計では、認可過程で妥協する必要はありません。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 中ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
注文番号	2546000000
種別	SV-SMT 7.62IT/04/90MSF2 2.6SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118556032
数量	110 Stück
製品データ	IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 40.5 A
パッケージ	Tape

SV-SMT 7.62IT/04/90MSF2 2.6SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	28.3 mm	奥行き (インチ)	1.114 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.551 inch
下位バージョンの高さ	11.4 mm	幅	38.1 mm
幅 (インチ)	1.5 inch	正味重量	8.8 g

システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズBV/SV 7.62HP	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	ピッチ (mm) (P)	7.62 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.3 "	外向きエルボ	90°
極数	4	極当たりソルダーピン数	2
ソルダーピン長 (l)	2.6 mm	ソルダーピン長 公差	+0.1 / -0.3 mm
はんだピン寸法	0.8 x 1.0 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.4 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	30.48 mm
L1 (インチ)	1.2 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	プリント基板のバックアップ ハンドタッチセーフ
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP 20	保護度合い	IP20, 完全取付け時
体積抵抗	2.00 mΩ	ねじフランジ用締付トルク、最小	0.2 Nm
ねじフランジ最大締付トルク	0.3 Nm	ブラギング回数	25
差し込み力 / 極、最大	12 N	引張強度 / 極、最大	7 N

材料データ

絶縁材	PA 9T	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	I
比較追跡指数 (CTI)	≥ 600	絶縁耐性	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
はんだ接続の層構造	1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt	プラグ接点の層構造	1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	130 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	130 °C

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	41 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	41 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	41 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	41 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	1,000 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	630 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	630 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/2	6 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2	6 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/3	6 kV	短時間耐電流抵抗	3 x 1sで420 A
クリアランス、最小	6.9 mm	沿面距離、最小	9.6 mm

SV-SMT 7.62IT/04/90MSF2 2.6SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)



証明書番号 (cURus)

E60693

定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) 300 V

定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) 300 V

定格電圧 (使用グループ C/UL 1059) 40.5 A

クリアランス距離、最小

6.9 mm

沿面距離、最小

9.6 mm

定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) 300 V

定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) 40.5 A

定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) 10 A

承認値への参照

仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

梱包

パッケージ

Tape

VPE 長

338 mm

VPE幅

130 mm

VPEの高さ

33 mm

テープの深さ (T2)

15.8 mm

テープ幅 (W)

56 mm

テープポケットの深さ (K0)

15.3 mm

テープポケットの高さ (A0)

28.4 mm

テープポケット幅 (B0)

39.06 mm

テープポケットの分離 (P1)

36 mm

テープホルルの分離 (E)

1.75 mm

テープポケットの分離 (F)

26.2 mm

テープリール径 (A)

330 mm

表面抵抗

$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$

分類

ETIM 6.0

EC002637

ETIM 7.0

EC002637

ETIM 8.0

EC002637

ETIM 9.0

EC002637

ECLASS 9.0

27-44-04-02

ECLASS 9.1

27-44-04-02

ECLASS 10.0

27-44-04-02

ECLASS 11.0

27-46-02-01

ECLASS 12.0

27-46-02-01

ECLASS 13.0

27-46-02-01

ECLASS 14.0

27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

重要なメモ

IPC準拠

適合性: 製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項

- 要求に応じて追加のバリエーション
- 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。
- 図面上のP = ピッチ
- 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。
- OMNIMATE コネクタは IEC 61984 に準拠した切断容量 (COC) のないコネクタです。指定された使用中、活性化中や負荷がかかっているときにコネクタを抜き差しすることはできません
- 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

作成日 2024/08/27 17:45:58 CEST

SV-SMT 7.62IT/04/90MSF2 2.6SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

ダウンロード

製品変更通知	20220105 Material change SV-SMT 7.62 20220105 Materialänderung SV-SMT
カタログ	Catalogues in PDF-format

SV-SMT 7.62IT/04/90MSF2 2.6SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 – 最新のドライブ技術用の最適化 (例: モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラー)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3 種の製品の種類には、さらに次の利点があります:

- アプリケーション志向の拡張性: 29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または 600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオプション

当社のサービス:

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを設計

一般注文データ

種別	BV/SV 7.62HP KO	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1937590000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,		箱
GTIN (EAN)	4032248608881	黒色, 極数: 1		
数量	50 Stück			

SV-SMT 7.62IT/04/270MF3

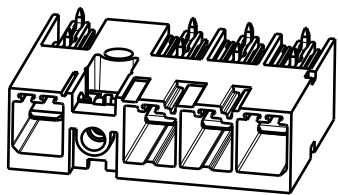


SV-SMT 7.62IT/04/270MSF3

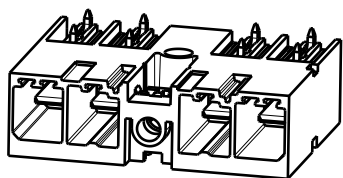


VKMU nur für MSF-Varianten /
square nut only for MSF-variants

SV-SMT 7.62IT/04/270MF2



SV-SMT 7.62IT/04/270MF3



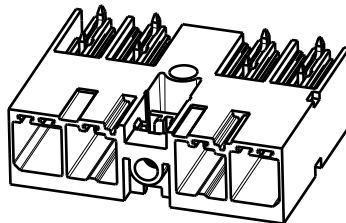
SV-SMT 7.62IT/04/270MF4



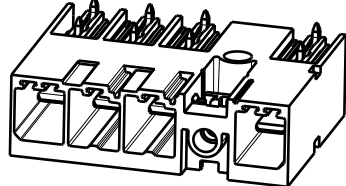
SV-SMT 7.62IT/04/270MSF2



SV-SMT 7.62IT/04/270MSF3



SV-SMT 7.62IT/04/270MSF4



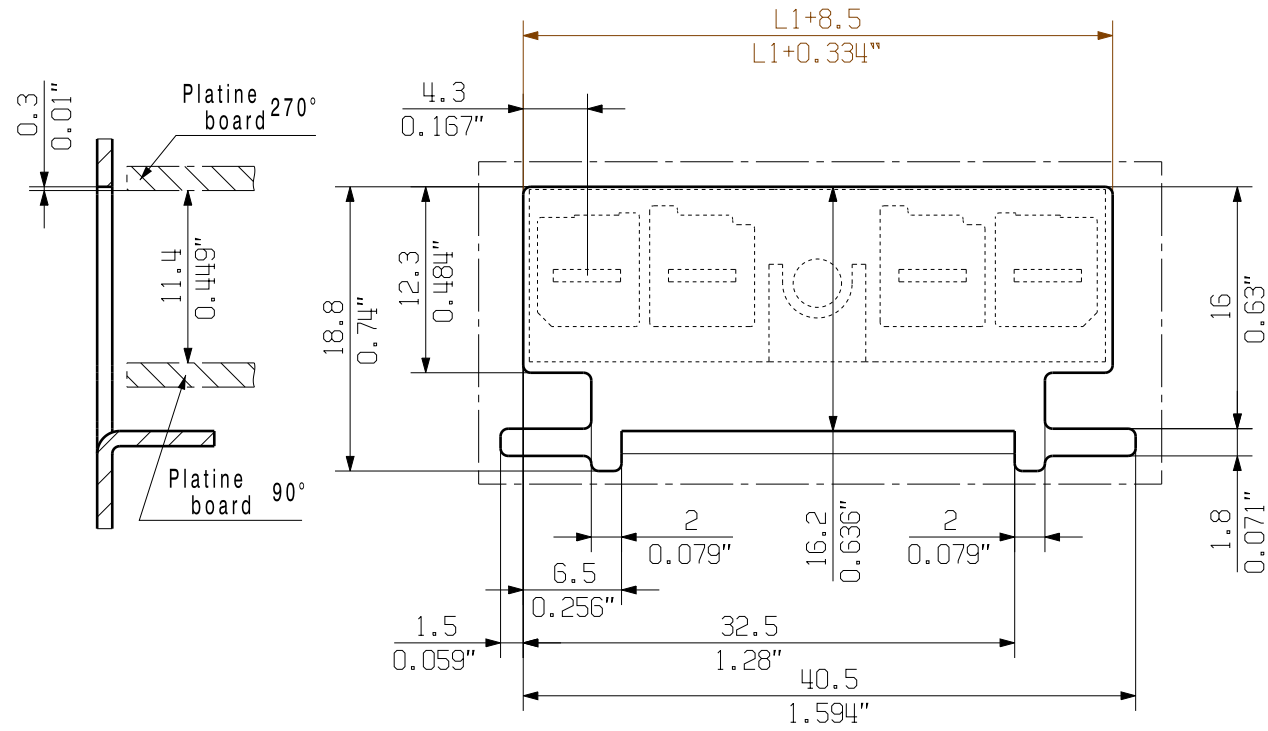
SO = ohne voreilenden Kontakt/
without leading pin

D = Ø1.4+0.1/-0.05
d = 0.8x1.0

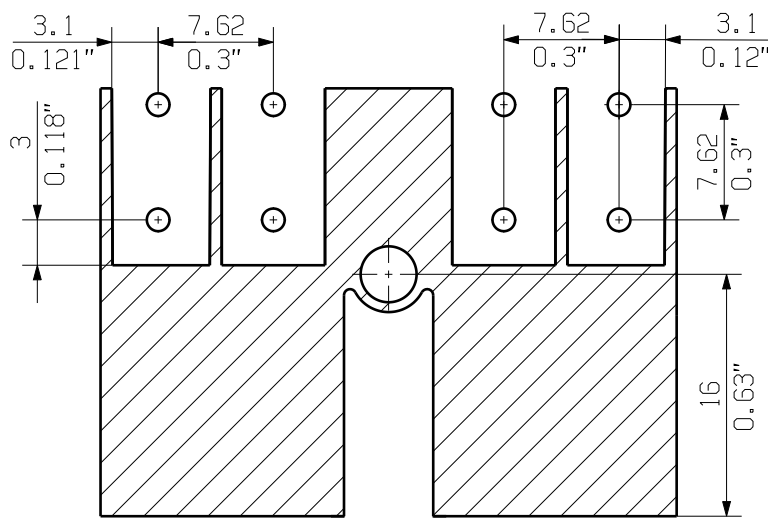
POL = Pol/pole
PE = Voreilender Kontakt / leading pin
P = Raster / pitch 7.62
MF= Mittelflansch
middle flange
MSF= Mittelschraubflansch
middle flange with screw

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.



hole pattern



paste free area
max. dimension

1.5
2.6
3.5
I
[mm]

GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-m

EC00002212	First Issue Date 14.11.2016	Max. nos.	Modification	Date	Name	Prim PLM Part No.: 225880	Prim ERP Part No.: 2499550000
		Drawn	30.08.2019	Helis, Maria		Weidmüller	63450
		Responsible	09.10.2019	Döhner, Karl		Sheet 16	of 17 sheets
		Approved	09.10.2019	Lang, Thomas		SV-SMT 7.62HP/IT/././90/270...	
						STISTLEISTE	
						MALE HEADER	
						Product file: 7407 BLF 7.50HP	

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.